(12) 特許公報(B2)

(11)特許番号

(24) 登録日 平成23年7月1日 (2011.7.1)

特許第4772815号

(P4772815)

(45) 発行日 平成23年9月14日(2011.9.14)

(19) 日本国特許庁(JP)

(51) Int.Cl.			FΙ		
GO3F	1/08	(2006.01)	G O 3 F	1/08	S
GOGT	1/00	(2006.01)	GOGT	1/00	305D
G01N	21/956	(2006.01)	GO1N	21/956	А

⁽全 18 頁) 請求項の数 3

 (21) 出願番号 (22) 出願日 (65) 公開番号 (43) 公開日 審査請求日 	特願2008-71959 (P2008-71959) 平成20年3月19日 (2008.3.19) 特開2009-229555 (P2009-229555A) 平成21年10月8日 (2009.10.8) 平成20年3月19日 (2008.3.19)	 (73)特許権者 000003078 株式会社東芝 東京都港区芝浦一丁目1番1号 (73)特許権者 000004237 日本電気株式会社
		東京都港区芝五丁目7番1号 (74)代理人 100119035 弁理士 池上 徹真 (74)代理人 100141036 弁理士 須藤 章 (74)代理人 100088487
		(14) 代主人 10000497 弁理士 松山 允之 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】補正パターン画像生成装置、パターン検査装置および補正パターン画像生成方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

試料のパターン検査に用いる検査基準パターン画像の補正を行う補正パターン画像生成 装置であって、

被検査パターン画像と前記検査基準パターン画像の位置合わせを行い、サブ画素単位の 相対シフト量を算出する相対シフト量算出部と、

前記検査基準パターン画像を、前記相対シフト量に基づいて垂直または水平方向のいず れか一方のシフト方向にシフトする画像シフト部と、

前記被検査パターン画像およびシフトした前記検査基準パターン画像に対して、第1の 10 線形予測モデルを用いた入出力関係を記述する第1の連立方程式を生成する第1の方程式 生成部と、

前記第1の連立方程式のパラメータを求める第1のパラメータ推定部と、

前記第1の連立方程式のパラメータが代入された前記第1の線形予測モデルを用いて、 前記検査基準パターン画像を、前記シフト方向に対し垂直な方向に補正した第1の補正パ ターン画像を生成する第1の補正パターン画像生成部と、

前記被検査パターン画像および前記第1の補正パターン画像に対して、第2の線形予測 モデルを用いた入出力関係を記述する第2の連立方程式を生成する第2の方程式生成部と

前記第2の連立方程式のパラメータを求める第2のパラメータ推定部と、 前記第2の連立方程式のパラメータが代入された前記第2の線形予測モデルを用いて、 前記第1の補正パターン画像を、前記シフト方向と同一の方向に補正した第2の補正パタ ーン画像を生成する第2の補正パターン画像生成部と、 を備え、

前記第1の線形予測モデルが1×n(nは3以上の整数)画素の領域を入力とする1× n次のモデルであり、かつ、前記第2の線形予測モデルがn×1画素の領域を入力とする n×1次のモデルであること、または、

前記第1の線形予測モデルがn×1画素の領域を入力とするn×1次のモデルであり、 かつ、前記第2の線形予測モデルが1×n画素の領域を入力とする1×n次のモデルであ ることを特徴とする補正パターン画像生成装置。

【請求項2】

10

請求項<u>1記載</u>の補正パターン画像生成装置を有することを特徴とするパターン検査装置

【請求項3】

試料のパターン検査に用いる検査基準パターン画像の補正を行う補正パターン画像生成 方法であって、

被検査パターン画像と前記検査基準パターン画像の位置合わせを行い、サブ画素単位の 相対シフト量を算出する相対シフト量算出ステップと、

前記検査基準パターン画像を、前記相対シフト量に基づいて垂直または水平方向のいず れか一方のシフトする画像シフトステップと、

前記被検査パターン画像およびシフトした前記検査基準パターン画像に対して、第1の ²⁰ 線形予測モデルを用いた入出力関係を記述する第1の連立方程式を生成する第1の方程式 生成ステップと、

前記第1の連立方程式のパラメータを求める第1のパラメータ推定ステップと、

前記第1の連立方程式のパラメータが代入された前記第1の線形予測モデルを用いて、 前記検査基準パターン画像を、前記シフト方向に対し垂直な方向に補正した、第1の補正 パターン画像を生成する第1の補正パターン画像生成ステップと、

前記被検査パターン画像および前記第1の補正パターン画像に対して、第2の線形予測 モデルを用いた入出力関係を記述する第2の連立方程式を生成する第2の方程式生成ステ ップと、

前記第2の連立方程式のパラメータを求める第2のパラメータ推定ステップと、 前記第2の連立方程式のパラメータが代入された前記第2の線形予測モデルを用いて、 前記第1の補正パターン画像を、前記シフト方向と同一の方向に補正した第2の補正パタ ーン画像を生成する第2の補正パターン画像生成ステップと、

を備え、

前記第1の線形予測モデルが1×n(nは3以上の整数)画素の領域を入力とする1× n次のモデルであり、かつ、前記第2の線形予測モデルがn×1画素の領域を入力とする n×1次のモデルであること、または、

前記第1の線形予測モデルがn×1画素の領域を入力とするn×1次のモデルであり、 かつ、前記第2の線形予測モデルが1×n画素の領域を入力とする1×n次のモデルであ ることを特徴とする補正パターン画像生成方法。

40

30

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、補正パターン画像生成装置、パターン検査装置および補正パターン画像生成 方法に関し、例えば、半導体リソグラフィ用マスクの欠陥検査に適用される補正パターン 画像生成装置、パターン検査装置および補正パターン画像生成方法に関する。

【背景技術】

[0002]

近年、大規模集積回路(LSI)の高集積化及び大容量化に伴い、半導体素子に要求さ 50

れる回路線幅はますます狭くなってきている。これらの半導体素子は、回路パターンが形 成された原画パターン(マスク或いはレチクルともいう。以下、マスクと総称する)を用 いて、いわゆるステッパと呼ばれる縮小投影露光装置でウェハ上にパターンを露光転写し て回路形成することにより製造される。

【0003】

そして、多大な製造コストのかかるLSIの製造にとって、歩留まりの向上は欠かせな い。歩留まりを低下させる大きな要因の一つとして、半導体ウェハ上に超微細パターンを 露光、転写する際に使用されるマスクのパターン欠陥があげられる。近年、半導体ウェハ 上に形成されるLSIパターン寸法の微細化に伴って、パターン欠陥として検出しなけれ ばならない寸法も極めて小さいものとなっている。そのため、LSI製造に使用される転 写用マスクの欠陥を検査するパターン検査装置の高精度化が必要とされている。 【0004】

パターン欠陥を検査する方法には、大きく分けて、ダイとダイとの比較(Die to Die比較:DD比較)検査と、ダイとデータベースとの比較(Die to Dat abase比較:DB比較)検査がある。DD比較検査は、レチクル上の2つのダイの測 定データ(検査基準パターン画像のデータと被検査パターン画像のデータ)を比較して欠 陥を検出する方法である。また、DB比較検査は、ダイの測定データ(被検査パターン画 像のデータ)とLSI設計用CADデータから発生させたダイの設計データ(検査基準パ ターン画像のデータ)を比較して欠陥を検出する方法である。

[0005]

DB比較検査では、試料はパターン検査装置のステージ上に載置され、ステージが動く ことによって光束が試料上を走査し、検査が行われる。試料には、光源及び照明光学系に よって光束が照射される。試料を透過あるいは反射した光は光学系を介して、センサ上に 結像される。センサで撮像された画像は測定データとして比較回路へ送られる。比較回路 では、画像同士の位置合わせの後、測定データと設計データとを適切なアルゴリズムに従 って比較し、一致しない場合には、パターン欠陥有りと判定する。

[0006]

ここで、近年、リソグラフィ用マスク上のパターンの微細化に伴い、比較対象画像同士 の画像位置ずれや画像の伸縮、うねり、センシングノイズなどに埋もれるような微小な欠 陥を検出する必要が生じている。そのために、検査基準パターン画像と被検査パターン画 像との高精度な位置合わせが必要となる。さらに、これらの欠陥を検出するためにも画像 補正が重要となる。このため、従来、検査基準パターン画像と被検査パターン画像の2つ の画像を比較検査する前段では、両画像のアライメントを行った後、画像の伸縮の補正(例えば、特許文献1参照)や画像のうねり補正、リサイズ補正、ノイズ平均化処理などの 画像補正を順に行っていた。

【0007】

しかしながら、このような補正を繰り返すことは累積誤差を生じさせ、画像が劣化する 大きな要因になっている。さらに、補正しすぎて検査基準パターン画像と被検査パターン 画像とが近似しすぎると今度は欠陥の検出が困難になってしまう。すなわち、過剰な補正 は逆効果になってしまう。

[0008]

また、特許文献2には、サブ画素レベルからの最終的な微調整のアライメントと画像補 正を統合化し、画像劣化が少なく、効果的な画像補正である入出力予測モデルを用いた画 像補正について開示されている。この画像補正は、例えば、検査基準パターン画像を入力 データ、被検査パターン画像を出力データとして線形予測モデルを用いて、サブ画素単位 のアライメントと画像補正を同時に実現するものである。この場合、画像データから行列 の関係式を作り、連立方程式を解くことによってモデルパラメータ(係数)を同定する。 そして同定されたモデルパラメータを適用した線形予測モデルに基づいて検査基準パター ン画像を補正し補正パターン画像を生成する。 【特許文献1】特開2000-241136号公報 20

10

30

【特許文献 2 】特許第 3 9 6 5 1 8 9 号公報 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【 0 0 0 9 】

本発明は、上述した問題点を克服し、検査対象試料の被検査パターン画像を適切に検査 するために、検査基準パターンの画像を適切に補正した補正パターン画像を生成する装置 及びその方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0010]

10 本発明の一態様の補正パターン画像生成装置は、試料のパターン検査に用いる検査基準 パターン画像の補正を行う補正パターン画像生成装置であって、被検査パターン画像と前 記検査基準パターン画像の位置合わせを行い、サブ画素単位の相対シフト量を算出する相 対シフト量算出部と、前記検査基準パターン画像を、前記相対シフト量に基づいて垂直ま たは水平方向のいずれか一方のシフト方向にシフトする画像シフト部と、前記被検査パタ ーン画像およびシフトした前記検査基準パターン画像に対して、第1の線形予測モデルを 用いた入出力関係を記述する第1の連立方程式を生成する第1の方程式生成部と、前記第 1の連立方程式のパラメータを求める第1のパラメータ推定部と、前記第1の連立方程式 のパラメータが代入された前記第1の線形予測モデルを用いて、前記検査基準パターン画 像を、前記シフト方向に対し垂直な方向に補正した第1の補正パターン画像を生成する第 20 1の補正パターン画像生成部と、前記被検査パターン画像および前記第1の補正パターン 画像に対して、第2の線形予測モデルを用いた入出力関係を記述する第2の連立方程式を 生成する第2の方程式生成部と、前記第2の連立方程式のパラメータを求める第2のパラ メータ推定部と、前記第2の連立方程式のパラメータが代入された前記第2の線形予測モ デルを用いて、前記第1の補正パターン画像を、前記シフト方向と同一の方向に補正した 第2の補正パターン画像を生成する第2の補正パターン画像生成部と、を備え、前記第1 の線形予測モデルが1×n(nは3以上の整数)画素の領域を入力とする1×n次のモデ ルであり、かつ、前記第2の線形予測モデルがn×1画素の領域を入力とするn×1次の モデルであること、または、前記第1の線形予測モデルがnx1画素の領域を入力とする n×1次のモデルであり、かつ、前記第2の線形予測モデルが1×n画素の領域を入力と 30 する1×n次のモデルであることを特徴とする。

【0012】

本発明の一態様のパターン検査装置は、上記補正パターン画像生成装置を有することを 特徴とする。

【0013】

本発明の一態様の補正パターン画像生成方法は、試料のパターン検査に用いる検査基準 パターン画像の補正を行う補正パターン画像生成方法であって、被検査パターン画像と前 記検査基準パターン画像の位置合わせを行い、サブ画素単位の相対シフト量を算出する相 対シフト量算出ステップと、前記検査基準パターン画像を、前記相対シフト量に基づいて 垂直または水平方向のいずれか一方のシフトする画像シフトステップと、前記被検査パタ ーン画像およびシフトした前記検査基準パターン画像に対して、第1の線形予測モデルを 用いた入出力関係を記述する第1の連立方程式を生成する第1の方程式生成ステップと、 前記第1の連立方程式のパラメータを求める第1のパラメータ推定ステップと、前記第1 の連立方程式のパラメータが代入された前記第1の線形予測モデルを用いて、前記検査基 準パターン画像を、前記シフト方向に対し垂直な方向に補正した第1の補正パターン画像 を生成する第1の補正パターン画像生成ステップと、前記被検査パターン画像および前記 第1の補正パターン画像に対して、第2の線形予測モデルを用いた入出力関係を記述する 第2の連立方程式を生成する第2の方程式生成ステップと、前記第2の連立方程式のパラメータが 代入された前記第2の線形予測モデルを用いて、前記第1の補正パターン画像を、前記シ

50

フト方向と同一の方向に補正した第2の補正パターン画像を生成する第2の補正パターン 画像生成ステップと、を備え、前記第1の線形予測モデルが1×n(nは3以上の整数) 画素の領域を入力とする1×n次のモデルであり、かつ、前記第2の線形予測モデルがn ×1画素の領域を入力とするn×1次のモデルであること、または、前記第1の線形予測 モデルがn×1画素の領域を入力とするn×1次のモデルであり、かつ、前記第2の線形 予測モデルが1×n画素の領域を入力とする1×n次のモデルであることを特徴とする。

【0014】

ここで、前記第1の線形予測モデルが1×n(nは3以上の整数)画素の領域を入力と 10 する1×n次のモデルであり、かつ、前記第2の線形予測モデルがn×1画素の領域を入 力とするn×1次のモデルであること、または、前記第1の線形予測モデルがn×1画素 の領域を入力とするn×1次のモデルであり、かつ、前記第2の線形予測モデルが1×n 画素の領域を入力とする1×n次のモデルであることが望ましい。

【発明の効果】

【0015】

本発明によれば、検査対象試料の被検査パターン画像を適切に検査するために、検査基 準パターンの画像を適切に補正した補正画像を生成する装置及びその方法を提供すること が可能となる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0016】

先に特許文献2を例に説明した補正パターン画像の生成方法においても、例えば、斜線 パターン等については、パターンシフトの方向が不定となることに起因して、適切な補正 が行えない事態が生じうる。また、斜線パターン等においては補正の適否の判定も困難で ある。このような場合、適切な補正が施されない検査基準パターン画像を用いることで、 検査対象試料の検査精度の低下を招く。

【0017】

そこで、以下の実施の形態では、リソグラフィ用マスク検査装置などのパターン検査装置における画像補正をする際に、垂直方向と水平方向を別個に補正する。この画像補正によれば、適切な検査基準パターンの補正が実現できる。以下、このように、多様なパターン画像に適応した効果的な画像補正装置、パターン検査装置および画像補正方法について説明する。

【0018】

[第1の実施の形態]

図2は、第1の実施の形態のパターン検査装置の構成を示すブロック図である。図2に おいて、パターンが形成された露光用マスクやウェハ等の基板を試料として、かかる試料 の欠陥を検査するパターン検査装置100は、光学画像取得部150と制御系回路160 を備えている。光学画像取得部150は、XY テーブル102、光源103、拡大光学 系104、フォトダイオードアレイ105、センサ回路106、レーザ測長システム12 2、オートローダ130、照明光学系170を備えている。制御系回路160では、コン ピュータとなる制御計算機110が、データ伝送路となるバス120を介して、位置回路 107、比較回路108、展開回路111、参照回路112、オートローダ制御回路11 3、テーブル制御回路114、磁気ディスク装置109、磁気テープ装置115、フレシ キブルディスク装置(FD)116、CRT117、パターンモニタ118、プリンタ1 19に接続されている。また、XY テーブル102は、X軸モータ、Y軸モータ、軸 モータにより駆動される。

【0019】

図2では、本実施の形態を説明する上で必要な構成部分以外については記載を省略して いる。パターン検査装置100にとって、通常、必要なその他の構成が含まれることは言 うまでもない。

30

[0020]

図1は、図2の比較回路の内部構成を示すブロック図である。図2において、比較回路 108は、メモリ142、メモリ144、位置合わせ部140、補正パターン画像生成部 200、及び比較部146を有している。

[0021]

メモリ142には、参照回路112から入力される参照データ(検査基準パターン画像 データ)が格納される。メモリ144には、センサ回路106から入力した測定データ(被検査パターン画像データ)が格納される。ここで、補正パターン画像生成部200は、 補正パターン画像生成装置の一例となる。

[0022]

そして、補正パターン画像生成部200は、相対シフト量算出部202、画像シフト部 204、第1の方程式生成部206、第1のパラメータ推定部208、第1の補正パター ン画像生成部210、第2の方程式生成部212、第2のパラメータ推定部214、第2 の補正パターン画像生成部216を有している。

図1では、本実施の形態を説明する上で必要な構成部分以外については記載を省略して いる。位置合わせ部140、補正パターン画像生成部200あるいは比較部146に、そ の他の構成が含まれても構わない。また、位置合わせ部140、補正パターン画像生成部 200、及び比較部146の各機能は、例えば、コンピュータで実行可能なソフトウェア で構成してもよい。但し、これに限るものではない。例えば、電気的な回路によるハード ウェアにより実施させても構わない。或いは、電気的な回路によるハードウェアとソフト ウェアとの組合せにより実施させても構わない。或いは、かかるハードウェアとファーム ウェアとの組合せでも構わない。同様に、相対シフト量算出部202、画像シフト部20 4、第1の方程式生成部206、第1のパラメータ推定部208、第1の補正パターン画 像生成部210、第2の方程式生成部212、第2のパラメータ推定部214、第2の補 正パターン画像生成部216の各機能は、例えば、コンピュータで実行可能なソフトウェ アで構成してもよい。或いは、電気的な回路によるハードウェアにより実施させても構わ ない。或いは、電気的な回路によるハードウェアとの組合せにより実施さ せても構わない。或いは、かかるハードウェアとファームウェアとの組合せでも構わない

【0024】

以下、パターン検査装置100の動作について図2を参照しつつ説明する。まず、光学 画像取得工程として、光学画像取得部150は、設計データに基づいてパターンが形成さ れた試料となるフォトマスク101の光学画像を取得する。具体的には、光学画像は、以 下のように取得される。

【0025】

被検査試料となるフォトマスク101は、XY 各軸のモータによって水平方向及び回転方向に移動可能に設けられたXY テーブル102上に載置される。そして、フォトマスク101に形成されたパターンには、XY テーブル102の上方に配置されている適切な光源103によって光が照射される。光源103から照射される光束は、照明光学系170を介してフォトマスク101を照射する。フォトマスク101の下方には、拡大光学系104、フォトダイオードアレイ105及びセンサ回路106が配置されており、フォトマスク101を透過した光は拡大光学系104を介して、フォトダイオードアレイ105に光学像として結像し、入射する。拡大光学系104は、図示しない自動焦点機構により自動的に焦点調整がなされていてもよい。

【0026】

図3は、光学画像の取得手順を説明するための図である。被検査領域は、図3に示すように、Y方向に向かって、スキャン幅Wの短冊状の複数の検査ストライプに仮想的に分割され、更にその分割された各検査ストライプが連続的に走査されるようにXY テーブル 102(図2)の動作が制御され、X方向に移動しながら光学画像が取得される。 10

20



[0027]

フォトダイオードアレイ105(図2)では、図3に示されるようなスキャン幅Wの画 像を連続的に入力する。そして、第1の検査ストライプにおける画像を取得した後、第2 の検査ストライプにおける画像を今度は逆方向に移動しながら同様にスキャン幅Wの画像 を連続的に入力する。そして、第3の検査ストライプにおける画像を取得する場合には、 第2の検査ストライプにおける画像を取得する方向とは逆方向、すなわち、第1の検査ス トライプにおける画像を取得した方向に移動しながら画像を取得する。このように、連続 的に画像を取得していくことで、無駄な処理時間を短縮することができる。

【0028】

フォトダイオードアレイ105上に結像されたパターンの像は、フォトダイオードアレ 10 イ105によって光電変換され、更にセンサ回路106によってA/D(アナログデジタ ル)変換される。フォトダイオードアレイ105には、例えば、TDI(タイムディレイ インテグレータ)センサのようなセンサが設置されている。ステージとなるXY テープ ル102をX軸方向に連続的に移動させることにより、TDIセンサは試料となるフォト マスク101のパターンを撮像する。これらの光源103、拡大光学系104、フォトダ イオードアレイ105、センサ回路106により高倍率の検査光学系が構成されている。 【0029】

XY テーブル102は、制御計算機110の制御の下にテーブル制御回路114により駆動される。X方向、Y方向、 方向に駆動する3軸(X-Y-)モータの様な駆動系によって移動可能となっている。これらの、X軸モータ、Y軸モータ、 軸モータは、例えばステップモータを用いることができる。そして、XY テーブル102の移動位置はレーザ測長システム122により測定され、位置回路107に供給される。また、XY テーブル102上のフォトマスク101はオートローダ制御回路113により駆動されるオートローダ130から自動的に搬送され、検査終了後に自動的に排出されるものとなっている。

[0030]

センサ回路106から出力された測定データ(被検査パターン画像データ:光学画像) は、位置回路107から出力されたXY テーブル102上におけるフォトマスク101 の位置を示すデータとともに比較回路108に送られる。測定データは例えば8ビットの 符号なしデータであり、各画素の明るさの階調を表現している。測定データは、例えば、 512画素×512画素の画像データ毎に比較される。

【0031】

一方、フォトマスク101のパターン形成時に用いた設計データは、記憶装置の一例で ある磁気ディスク装置109に記憶される。そして、設計データは、磁気ディスク装置1 09から制御計算機110を通して展開回路111に読み出される。そして、展開回路1 11は、読み出された被検査試料となるフォトマスク101の設計データを2値ないしは 多値のイメージデータに変換して、このイメージデータが参照回路112に送られる。 【0032】

ここで、設計データは長方形や三角形を基本図形としたもので、例えば、図形の2つの 頂点位置における座標(×、y)や、長方形や三角形等の図形種を区別する識別子となる 図形コードといった情報で各パターン図形の形、大きさ、位置等を定義した図形データが 格納されている。かかる図形データとなる設計データが展開回路111に入力されると、 図形ごとのデータにまで展開される。そして、その図形データの図形形状を示す図形コー ド、図形寸法などを解釈する。そして、所定の量子化寸法のグリッドを単位とするマス目 内に配置されるパターンとして2値ないしは多値の図形パターンデータに展開される。 【0033】

言い換えれば、設計データを読み込み、検査領域を所定の寸法を単位とするマス目として仮想分割してできたマス目毎に設計データにおける図形データが示す図形が占める占有率を演算し、nビットの占有率データが生成され、内部のパターンメモリに出力される。 例えば、1つのマス目を1画素として設定すると好適である。そして、1画素に1/2⁸

30

20

(=1/256)の分解能を持たせるとすると、画素内に配置されている図形の領域分だ け1/256の小領域を割り付けて画素内の占有率を演算する。そして、8ビットの占有 率データとして生成され、内部のパターンメモリに格納される。

【0034】

そして、参照回路112は、展開回路111から送られてきた図形のイメージデータから測定データと比較するための参照データ(検査基準パターン画像データ)を作成する。 比較対象となる参照データは、測定データと同様、例えば、512画素×512画素の画像データとして作成される。

【0035】

ここでは、「die to database検査」を行うために設計データに基づい ¹⁰ て参照データを作成しているが、これに限るものではない。「die to die検査 」を行うこともできる。その場合には、比較対象となる別の測定データ(光学画像)に基 づいて参照データを作成すればよい。そして、参照データは、比較回路108に送られる

【0036】

比較回路108では、参照データと測定データを取り込む。そして、参照データ(検査 基準パターン画像データ)は、図1に示すメモリ142に格納される。また、測定データ (被検査パターン画像データ)は、メモリ144に格納される。そして、位置合わせ部1 40が、1画素単位でシフトして画素位置ズレを補正しておく。つまり、両画像の位置ズ レを1画素未満に追い込んでおく。予め、両画像の対応する各画素の階調差の2乗和など で表される評価関数を最小にする位置に合わせればよい。

20

30

【0037】

その後、後に詳述する方法で参照データ(検査基準パターン画像データ)を補正して補 正パターン画像を生成した後に、補正パターン画像データと測定データとを所定のアルゴ リズムに従って比較し、欠陥の有無を判定する。

【0038】

図4は、本実施の形態における補正パターン画像生成方法の要部工程について示すフロ ーチャート図である。図4において、補正パターン画像生成方法は、相対シフト量算出ス テップS10、画像シフトステップS12、第1の方程式生成ステップS14、第1のパ ラメータ推定ステップS16、第1の補正パターン画像生成ステップS18、第2の方程 式生成ステップS20、第2のパラメータ推定ステップS22、第2の補正パターン画像 生成ステップS24という一連の工程を実施する。そして、その後、検査工程として、第 2の補正パターン画像と被検査パターン画像とを比較する比較ステップS26を実施する

【0039】

相対シフト量算出ステップS10において、相対シフト量算出部202(図1)は、被検査パターン画像と検査基準パターン画像の位置合わせを行い、被検査パターン画像と検 査基準パターン画像のサブ画素単位の相対シフト量を算出する。

【0040】

ー般に、サブ画素単位での水平方向のシフト量を1、垂直方向のシフト量をmとすると 40 、画像uを1,mだけシフトした画像u''は、バイキュービック補間法と呼ばれる以下 の式(1-1)と式(1-2)で求めることができる。シフト量の求め方は、例えばシフ ト量を所定の範囲で振って、シフト後の階調差の二乗和が最小となるシフト量を求める方 法などがある。 【数1】

(1-1)
$$u'_{i,j} = \sum_{k=0}^{4} p_k u_{i,j+k-2}$$

(1-2)
$$u''_{i,j} = \sum_{k=0}^{4} q_k u'_{i+k-2,j}$$

ここで、p、qは次式で与えられる。 【数2】 $p_0 = 0$ $p_1 = -\frac{1}{2}l(l-1)^2$

$$p_{2} = \frac{1}{2}(l-1)(3l^{2}-2l-2)$$

$$p_{3} = \frac{1}{2}l(1+4l-3l^{2})$$

$$\frac{1}{2}l(1+4l-3l^{2})$$

$$p_4 = \frac{1}{2}l^2(l-1)$$

 $a_{2}=0$

$$q_{1} = -\frac{1}{2}m(m-1)^{2}$$

$$q_{2} = \frac{1}{2}(m-1)(3m^{2}-2m-2)$$

$$q_{3} = \frac{1}{2}m(1+4m-3m^{2})$$

$$q_{4} = \frac{1}{2}m^{2}(m-1)$$

本実施の形態においても、画像のシフト演算はバイキュービック補間法で行うものとす るが、画像のシフト演算はバイキュービック補間法に限定されず、直線補間法やスプライ ン補間法などを用いることができる。

【0041】

なお、本実施の形態において、以下、被検査画像をy、検査基準画像をu、検査基準パ ターン画像を相対シフト量算出ステップS10で求めた相対シフト量に基づいてシフトさ せた画像、すなわちシフトさせた検査基準画像をv、第1の補正パターン画像をw、第2 の補正パターン画像をxという記号で表すものとする。 20

10

30

[0042]

画像シフトステップS12において、画像シフト部204(図1)は、S10で得られ た相対シフト量に基づいて、検査基準パターン画像 u を垂直方向にのみシフトさせる。具 体的には、式(1-1)と式(1-2)において、1=0とすることにより検査基準パタ ーン画像を垂直方向にのみシフトさせた検査基準パターン画像 v を生成する。

(10)

【0043】

次に、第1の方程式生成ステップS14、第1のパラメータ推定ステップS16、第1 の補正パターン画像生成ステップS18の一連のステップで、検査基準パターン画像uを 、画像シフトステップS12においてシフトした方向に対し垂直な方向に補正する。この 実施の形態においては、画像シフトステップS12で検査基準パターン画像uを垂直方向 にシフトしているため、これに垂直な方向、すなわち水平方向の補正を行う。画像シフト ステップS12において、サブ画素単位の垂直方向の位置合わせを行った結果、水平方向 により精度の高い補正を行うことができる。

[0044]

まず、第1の方程式生成ステップS14において、第1の方程式生成部206は、被検 査パターン画像 y のデータと対応するシフトされた検査基準パターン画像 v のデータとを 用いて、第1の線形予測モデルに基づく連立方程式を生成する。以下、シフトした検査基 準パターン画像 v を入力データと見なし、被検査パターン画像 y を出力データと見なして 、第1の線形予測モデルを設定する方法について説明する。

[0045]

ここでは、第1の線形予測モデルとして、1×5画素の領域を用いた1×5次の線形予 測モデルを用いる。このモデルで用いるサフィックスを以下の表(1)に示す。

【表1】

|--|

【0046】

表(1)に示すようにサフィックスを取り、入力データ(階調値)と出力データ(階調値)をそれぞれv(i,j)、y(i,j)あるいはv_i,j、y_i,jとする。図5は、第1の線形予測モデルを説明するための図である。被検査パターン画像10の着目する 画素20のサフィックス(座標)をi,jとする。そして、シフトした検査基準パターン 画像12で同じ座標の画素26と画素26の左右2個ずつの画素28の合計5個の画素の サフィックスを表(1)のように設定する。そして、ある1組の1×5領域の画素データ について、以下に示す式(3)のような関係式を設定する。

(3) $y_k = y(i, j)$ (3) $= a_0 v(i, j-2) + a_1 v(i, j-1) + a_2 v(i, j) + a_3 v(i, j+1) + a_4 v(i, j+2)$ $+ \varepsilon(i, j)$

[0047]

ここで、式(3)に示す関係式における各座標のシフトした検査基準パターン画像デー タv(i,j)に乗じるa₀~a₄は、同定すべきモデルパラメータ(係数)である。式 (3)の意味するところは、被検査パターン画像10のある1画素20のデータy_k=y (i,j)は、対応するシフトした検査基準パターン画像12の1画素26とその左右の 画素28とで構成する1×5画素のデータの線形結合で表すことができるということであ る。このように、線形予測モデルで畳み込み演算を行なうことで、画像のうねりやノイズ を補正することができる。式(3)をベクトル形式(行列形式)で表すと、式(4-1) ~式(4-3)のように示すことができる。 20

10

30

[数 4]
(4−1)
$$\alpha = [a_0, a_1, \cdots, a_4]^T$$

(4-2)
$$x_k = [v(i, j-2), v(i, j-1), \cdots, v(i, j+2)]^T$$

$$(4-3) \qquad x_k^{T} \alpha = y_k$$

【0048】

ここで、式(4 - 1) ~ 式(4 - 3)において、シフトした検査基準パターン画像 v と 被検査パターン画像 y の座標(i, j)を走査して 5 組のデータを連立させれば、モデル パラメータを同定することができる。ここで、統計的観点から、以下の式(5 - 1)のよ うに n (>5)組のデータを用意して、以下の式(5 - 2)のような最小 2 乗法に基づい て 5 次元の連立方程式を解き、 を同定しても好適である。この様な方程式の解法として は、最小 2 乗法の他に最尤推定法などがあり、どのような方法を使用しても構わない。 【数 5】

(11)

(5-1)
$$\begin{bmatrix} X_1^T \\ \vdots \\ X_n^T \end{bmatrix} \cdot \alpha = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

20

10

 $(5-2) \qquad (A^T \cdot A)\alpha = A^T \cdot y$

ここで、A = [x ₁ , x ₂ , ... x _n] ^T、y = [y ₁ , y ₂ , ... y _n] ^T、k = 1 , 2 , ... n である。

【0049】

例えば、シフトした検査基準パターン画像12と被検査パターン画像10がそれぞれ5 12×512画素であれば、約25万組のデータが得られることになり、統計的に見て充 分な個数を確保することができる。第1の方程式生成部206(図1)は、被検査パター ン画像と被検査パターン画像から式(5-1)及び式(5-2)の連立方程式、すなわち 、5×5要素のマトリックス(A^TA)と、5要素のベクトルA^Tyを生成する。

[0050]

第1のパラメータ推定ステップS16において、第1のパラメータ推定部208は、式 (5-1)及び式(5-2)の連立方程式を解いて、パラメータ (係数)を算出する演 算を行う。すなわち、パラメータa₀~a₄(係数)を算出する。

【0051】

第1の補正パターン画像生成ステップS18として、第1の補正パターン画像生成部2 10は、第1の連立方程式のパラメータが代入された第1の線形予測モデルを用いて、画 像シフトステップS12でシフトする前の検査基準パターン画像uを、画像シフトステッ プS12のシフト方向に対し垂直な方向、ここでは水平方向に補正した第1の補正パター ン画像wを生成する。すなわち、第1のパラメータ推定ステップS16で得られたパラメ ータajを以下の式(6)に示すように用いて、座標(i,j)の第1の補正パターン画 像データw_{i,j}を演算する。そして、演算結果を第2の方程式生成部212に出力する 。ここで、u_{i,j}は検査基準パターン画像データである。

30

(12)

【数6】

(6)
$$W_{i,j} = \sum_{r=0}^{4} a_r u_{i,j+r-2}$$

【0052】

以上のようにして、第1の補正パターン画像生成部210は、第1のパラメータ推定部 208で得られたパラメータ を用いて、検査基準パターン画像uに対し、水平方向の補 正を加えた第1の補正パターン画像wを生成する。

【0053】

次に、第2の方程式生成ステップS20、第2のパラメータ推定ステップS22、第2 の補正パターン画像生成ステップS24の一連のステップで、第1の補正パターン画像w を、画像シフトステップS12でのシフト方向と同一の方向に補正する。この実施の形態 においては、画像シフトステップS12が垂直方向にシフトしているため、これと同一の 垂直方向の補正を行う。すなわち、水平方向に補正が行われた第1の補正パターン画像w に対し、垂直方向の補正を行うことになる。

【0054】

まず、第2の方程式生成ステップS20において、第2の方程式生成部212は、被検 査パターン画像 y のデータと対応する第1の補正パターン画像 w のデータとを用いて、第 2の線形予測モデルに基づく連立方程式を生成する。以下、第1の補正パターン画像 w を 入力データと見なし、被検査パターン画像 y を出力データと見なして第2の線形予測モデ ルを設定する方法について説明する。

【 0 0 5 5 】

ここでは、第2の線形予測モデルとして、5×1画素の領域を用いた5×1次の線形予 測モデルを用いる。このモデルで用いるサフィックスを以下の表(2)に示す。 【表2】

i−2, j
i−1, j
i, j
i+1, j
i+2, j
[0056]

表(2)に示すようにサフィックスを取り、入力データ(階調値)と出力データ(階調値)をそれぞれw(i,j)、y(i,j)とする。図6は、第2の線形予測モデルを説明するための図である。被検査パターン画像10の着目する画素20のサフィックス(座標)をi,jとする。そして、第1の補正パターン画像14で同じ座標の画素22と画素22の上下2個ずつの画素24の合計5個の画素のサフィックスを表(2)のように設定する。そして、ある1組の5×1領域の画素データについて、以下に示す式(7)のような関係式を設定する。

【数7】

(7)
$$y_k = y(i, j)$$

(7) $= b_0 w(i-2, j) + b_1 w(i-1, j) + b_2 w(i, j) + b_3 w(i+1, j) + b_4 w(i+2, j)$
 $+ \varepsilon (i, j)$

[0057]

10

20

30

(13)

ここで、第1の方程式生成ステップS14と同様に

【数8】

(8-1)	β =	[b ₀ ,	b ₁ ,	•••,	b ₄] [⊤]
-------	-----	-------------------	------------------	------	-------------------------------

(8-2)
$$x_k = [w(i-2, j), w(i-1, j), \cdots, w(i+2, j)]^T$$

$$(8-3) \qquad \mathbf{x}_{k}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{y}_{k}$$

として、次の式(9)の第2の連立方程式を生成する。

【数9】

(9) $(A^T \cdot A)\beta = A^T \cdot y$

ここで、A = [x ₁ , x ₂ , ... x _n] ^T、y = [y ₁ , y ₂ , ... y _n] ^T、k = 1 , 2 , ... n である。

【 0 0 5 8 】

第2のパラメータ推定ステップS22として、第2のパラメータ推定部214は、式(9)の連立方程式を解いて、この連立方程式における各座標の第1の補正パターン画像w に乗じるパラメータ (係数)を算出する演算を行う。

【0059】

第2の補正パターン画像生成ステップS24として、第2の補正パターン画像生成部2 16は、得られた第2の補正モデルパラメータbjを以下の式(10)に示すように用い て、座標(i,j)の第2の補正パターン画像データ×_i,jを演算する。そして、演算 結果を比較部146に出力する。ここで、w_i,jは第1の補正パターン画像データであ る。

【数10】

(10)
$$x_{i,j} = \sum_{r=0}^{4} b_r w_{i+r-2,j}$$

30

40

10

20

[0060]

以上のようにして、第2の補正パターン画像生成部は、第2のパラメータ推定部で得られたパラメータ を用いて、第1の補正パターン画像wから第2の補正パターン画像×を 生成する。

【0061】

比較ステップS26として、比較部146は、第2の補正パターン画像データ×_{i,j} と被検査パターン画像データy(i,j)とを所定のアルゴリズムを用いて比較する。そ して、欠陥の有無を検査し、その結果を出力する。

【0062】

図7は、本実施の形態の作用を説明する図である。ここで、パターンAをパターンBに あわせる補正を行う場合を例に説明する。パターンAとパターンBは2つの異なる画像に 個別に含まれており、図では重ねて表示している。補正のパラメータが2次元の場合、す なわち、補正のシフトが水平、垂直方向同時に行われる場合、図中破腺矢印で示すように 、パターンのエッジと平行な方向へのシフト量が任意となる。その結果、推定で得られる シフトパラメータの、パターンのエッジと平行な方向の寄与が不定となり、良好なシフト パラメータを得られない可能性がある。例えば、シフトする画像に欠陥像があった場合、 その欠陥像がパターンのエッジと平行な方向にぼけてしまうことがある。 【0063】

これに対し、本実施の形態の第1のパターン画像生成、第2のパターン画像生成のよう に、補正のパラメータを1次元に限定する場合、すなわち、補正のシフトが水平方向また は垂直方向のいずれかに固定される場合、図中実線矢印で示すように、2つのパターンの エッジ位置が一致する場所が存在する。このように、推定する係数の自由度がパターンの エッジ位置で拘束されるので、良好なシフトパラメータを得ることできる。ただし、画像 が水平あるいは垂直方向のパターンのみで占められている場合は、水平あるいは垂直方向 のパラメータが不定となることがある。この場合でもシフトパラメータが1次元であるた め、パラメータが異常であることが、パラメータの重心判定等により容易に判別できる。 また、式(1 - 1)、(1 - 2)と式(6)、(1 0)は同形である。したがって、異常 なパラメータは、前述のバイキュービック補間法パラメータpあるいは q と置き換えるこ とが可能であり、その操作によって良好な補正画像を得ることができる。

以上のように、上述したステップで生成した第2の補正パターン画像×は、補正のシフト方向が不定となることに起因して欠陥信号が劣化することを回避しながら、検査基準画像 u を被検査パターン画像 y に合わせて補正した画像に相当する。特に水平方向、垂直方向を逐次推定する効果により、斜線パターン等に見られる、ある方向成分が不定となるような場合に良好な推定が行える。従って、ここで得られた第2の補正パターン画像×と、 被検査パターンy を比較することにより、高精度な検査を行うことができる。 【0065】

なお、本実施の形態においては、検査基準パターン画像を、相対シフト量に基づいて垂 20 直方向のシフト方向にシフトし、その後、水平方向の補正、垂直方向の補正を逐次行う場 合を例に説明した。しかし、検査基準パターン画像を、相対シフト量に基づいて水平方向 のシフト方向にシフトし、その後、垂直方向の補正、水平方向の補正を逐次行っても同様 の効果を得ることが可能である。

【0066】

また、第1の線形予測モデルが1×5画素の領域を用いた1×5次のモデルであり、か つ、第2の線形予測モデルが5×1画素の領域を用いた5×1次のモデルである場合を例 に説明した。補正の精度および計算処理時間の観点からは、1×5次、5×1次程度が適 当である。しかし、必ずしも、1×5次のモデルおよび5×1次のモデルである必要はな く、nを3以上の任意の整数とする1×n次のモデルおよびn×1次のモデルを採用する ことが可能である。そして、第1の線形予測モデルがn×1画素の領域を用いたn×1次 のモデルであり、かつ、第2の線形予測モデルが1×n画素の領域を用いた1×n次のモ デルとしても構わない。

[0067]

図8は、別の光学画像の取得手順を説明するための図である。図2の構成では、スキャン幅Wの画素数(例えば2048画素)を同時に入射するフォトダイオードアレイ105 を用いているが、これに限るものではなく、図8に示すように、XY テーブル102を X方向に定速度で送りながら、レーザ干渉計で一定ピッチの移動を検出した毎にY方向に 図示していないレーザスキャン光学装置でレーザビームをY方向に走査し、透過光を検出 して所定の大きさのエリア毎に二次元画像を取得する手順を用いても構わない。

【0068】

以上の説明において、「~回路」或いは「~ステップ」と記載したものは、コンピュー タで動作可能なプログラムにより構成することができる。或いは、ソフトウェアとなるプ ログラムだけではなく、ハードウェアとソフトウェアとの組合せにより実施させても構わ ない。或いは、ファームウェアとの組合せでも構わない。また、プログラムにより構成さ れる場合、プログラムは、磁気ディスク装置、磁気テープ装置、FD、或いはROM(リ ードオンリメモリ)等の記録媒体に記録される。例えば、図2の演算制御部を構成するテ ーブル制御回路114、展開回路111、参照回路112、比較回路108等は、電気的 回路で構成されていても良いし、制御計算機110によって処理することのできるソフト ウェアとして実現してもよい。また電気的回路とソフトウェアの組み合わせで実現しても 10

30

良い。

【0069】

以上、具体例を参照しつつ実施の形態について説明した。しかし、本発明は、これらの 具体例に限定されるものではない。例えば、各実施の形態では、透過光を用いているが、 反射光あるいは、透過光と反射光を同時に用いてもよい。検査基準パターン画像となる参 照画像は設計データから生成しているが、フォトダイオードアレイ等のセンサにより撮像 した同ーパターンのデータを用いても良い。言い換えれば、die to die検査で もdie to database検査でも構わない。

(15)

[0070]

また、装置構成や制御手法等、本発明の説明に直接必要しない部分等については記載を ¹⁰ 省略したが、必要とされる装置構成や制御手法を適宜選択して用いることができる。その 他、本発明の要素を具備し、当業者が適宜設計変更しうる全ての補正パターン画像生成装 置、パターン検査装置、或いは補正パターン画像生成方法は、本発明の範囲に包含される

【図面の簡単な説明】

【0071】

- 【図1】実施の形態の比較回路の内部構成を示すブロック図である。
- 【図2】実施の形態のパターン検査装置のブロック図である。
- 【図3】実施の形態の光学画像の取得手順を説明するための図である。

【図4】実施の形態における補正パターン画像生成方法の要部工程について示すフローチ 20 ャート図である。

- 【図5】実施の形態の第1の線形予測モデルを説明するための図である。
- 【図6】実施の形態の第2の線形予測モデルを説明するための図である。
- 【図7】実施の形態の作用を説明する図である。
- 【図8】別の光学画像の取得手順を説明するための図である。

【符号の説明】

【 0 0 7 2 】

100 パター:	ン検査装置
----------	-------

- 108 比較回路
- 140 位置合わせ部
- 146 比較部
- 200 補正パターン画像生成部
- 202 相対シフト量算出部
- 204 画像シフト部
- 206 第1の方程式生成部
- 208 第1のパラメータ推定部
- 2 1 0 第 1 の 補正パターン 画 像 生 成 部
- 212 第2の方程式生成部
- 2 1 4 第 2 のパラメータ推定部
- 2 1 6 第 2 の補正パターン画像生成部

30





【図3】













(17)



フロントページの続き

(72)発明者 杉原 真児 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 アドバンスド・マスク・インスペクション・テクノロジー 株式会社内

審查官 新井 重雄

(56)参考文献 特開2008-233343(JP,A) 特開2008-165198(JP,A) 特開2008-165198(JP,A) 特開2008-164593(JP,A) 特開2007-087210(JP,A) 特開2007-087210(JP,A) 特開2006-284617(JP,A) 特開2006-284617(JP,A) 特開2001-388304(JP,A) 特開2001-388304(JP,A) 特開2001-388304(JP,A) 特開平07-086349(JP,A) 特開昭62-168270(JP,A)

(58)調査した分野(Int.CI., DB名) G03F 1/08 G01N 21/956 G06T 1/00